



半导体

【粤开 TMT】半导体行业周报：汽车芯片荒持续，关注涨价受益标的

2021 年 03 月 01 日

投资要点

分析师：陈梦洁

执业编号：S0300520100001

电话：010-64814022

邮箱：chenmengjie@y kzq.com

研究助理：姜楠宇

邮箱：jiangnanyu@y kzq.com

近期报告

《【粤开医药行业周报】带量采购常态化、制度化开启，核酸检测价格下调》
2021-02-01

《【粤开医药行业周报】生物类似药相似性评价正式启动》2021-02-23

近五年半导体板块相对沪深 300 表现



数据来源：wind

行业核心观点

长期来看，半导体板块在景气周期+国产替代双重逻辑之下，预计景气度持续。半导体行业呈现螺旋式上升的规律，技术变革是驱动行业持续增长的主要推动力。当前全球经济逐渐进入后疫情的复苏时代，需求方面 5G、AI、数据中心、新能源车、IOT 等领域对半导体的需求持续旺盛，带动芯片需求增长；供给方面，近期自然灾害冲击产能，制造商产能利用率持续满载。

短期来看，汽车芯片荒持续，半导体产业链涨价，关注相关的产业链受益标的。近期汽车芯片荒的表面原因是短期的供不应求，实质原因是车企对芯片的重视和了解不足。本次汽车芯片荒主要集中在车辆电子稳定系统 ESP 和电子控制器单元 ECU 系统，MCU 芯片价格低廉，车企主要采取外包模式，据 IHS 统计，台积电承包了全球 70% 的 MCU 产量。汽车芯片制造商的主要客户是 Tier1 厂商，如博世、电装等，而整车厂商对芯片厂商的了解不足，低估了订单周期，造成了此次汽车短缺危机。此次汽车芯片荒将推动汽车零部件厂商对汽车芯片相关投资和配套产能的重视，汽车芯片相关标的（韦尔股份、紫光国微、士兰微、扬杰科技等）和半导体晶圆设备厂商（北方华创、中微公司等）有望受益。

多家半导体公司发布涨价函，且被动元件及存储芯片全线涨价。从 20Q4 起，由晶圆供货紧张引发的缺货效应正在半导体产业链内传导，已有包括士兰微、华润微、汇顶科技、意法半导体、Microchip、恩智浦等在内的多家半导体厂商发布涨价函，涨幅平均在 10%-20% 之间。据 Digitimes，MLCC 两大指标厂商韩国三星电机、日商 TDK 通知高容 MLCC 供应持续紧张，即将调涨 MLCC 报价。DRAM、NAND 和 NOR Flash 全线涨价。建议关注被动元件行业及存储行业龙头标的：风华高科、顺络电子、三环集团、兆易创新等。

风险提示：宏观经济波动、疫情控制不及预期、半导体产业链国产化进程低于预期



目 录

一、周度行业观点	3
(一) 近期热点动态跟踪	3
1、汽车芯片荒	3
2、产业链涨价持续	3
3、预计一季度晶圆代工营收增长 20%	5
二、市场行情回顾	6
(一) 市场动态监测	6
(二) 高频数据跟踪	8
(三) 公司公告	8
(三) 行业动态	11

图表目录

图表 1：DRAM 现货平均价上涨 (美元)	4
图表 2：NANDFlash 现货平均价 (美元)	4
图表 3：WSTS 全球半导体市场规模预测	5
图表 4：2021 年一季度全球前十大晶圆代工业者营收排名预测 (百万美元)	5
图表 5：上周主要指数情况	6
图表 6：上周中信一级行业涨跌幅	6
图表 7：上周半导体细分板块市场表现	7
图表 8：近五年申万半导体指数 PE (TTM)	7
图表 9：申万半导体指数与创业板指 PE (TTM) 对比	7
图表 12：台股半导体企业月度营收数据 (更新至 21 年 1 月)	8
图表 13：近期重要公司公告一览	8
图表 14：近期行业新闻梳理	11



一、周度行业观点

(一) 近期热点动态跟踪

1、汽车芯片荒

当地时间 2 月 13 日，日本福岛地区发生 7.3 级地震，瑞萨、村田、信越化学等工厂出现停滞，现在已部分恢复运行。2 月 16 日，美国德州因暴雪影响停电，导致三星、恩智浦、德州仪器等半导体公司部分工厂产能出现停滞。

近期自然灾害冲击进一步加剧全球半导体紧缺，芯片短缺料将持续。(1) 日本的瑞萨茨城厂主要生产车用芯片及 MCU；信越是全球硅晶圆龙头；胜高的日本东北部工厂占全球硅片产能约 20%；同时多家化材上游供应商亦停电暂定生产，**行业关键材料如光刻胶或面临缺口。**(2) 美国被迫停工的三星工厂主要进行 DRAM、NANDFlash 芯片以及逻辑芯片代工，据 Trendforce 预估，三星此次受影响的产能占全球 12 寸产能约 1-2%；恩智浦生产 MCU、PMIC 等；英飞凌奥斯汀工厂主要生产 NOR、MCU 及汽车芯片。三星电子为全球主要的芯片厂商，恩智浦、英飞凌均为全球主要汽车零部件供应商，通常停工后需一周左右恢复产能，**停工加剧全球半导体的短缺，汽车芯片持续紧俏，全球晶圆制造的高景气上行周期将持续，同时部分急单亦有望提升接单 ASP。**

近期汽车芯片荒的表面原因是短期的供不应求。2020 年受疫情影响，汽车零部件订单量下调，而 2020 年三-四季度销售快速回暖，造成了零部件供求缺口。由于彼时居家办公、消费电子和数据中心的芯片需求已经较大，汽车厂商重新下单时，晶圆厂产能紧张，无额外的汽车芯片产能。

汽车芯片荒的实质原因是车企对芯片的重视和了解不足。本次汽车芯片荒主要集中在车辆电子稳定系统 ESP 和电子控制器单元 ECU 系统，MCU 芯片价格低廉，车企主要采取外包模式，据 IHS 统计，台积电承包了全球 70% 的 MCU 产量。汽车芯片制造商的主要客户是 Tier1 厂商，如博世、电装等，而整车厂商对芯片厂商的了解不足，低估了订单周期，造成了此次汽车短缺危机。

此次汽车芯片荒将推动汽车零部件厂商对汽车芯片相关投资和配套产能的重视。零部件供应商大陆已经表示，未来将加大供应链投资；英飞凌将在奥地利建立基于 12 英寸晶圆的新工厂。**汽车芯片相关标的（韦尔股份、紫光国微、士兰微、扬杰科技等）和半导体晶圆设备厂商（北方华创、中微公司等）有望受益。**

2、产业链涨价持续

(1) 多家半导体厂商发布涨价函

士兰微电子 2 月 23 日发布调价函称，由于受原辅材料及封装价格上涨的影响，公司相关产品的成本不断上升，为了保证产品的供应，保持良好的业务关系，从 2021 年 3 月 1 日起对部分分立器件产品价格进行调整(所有 MS 类产品、IGBT、SBD、FRD、功率对管等)。

从 20Q4 起，由晶圆供货紧张引发的缺货效应正在半导体产业链内传导，上游原材料以及封装成本持续上涨，叠加产能紧张、采购周期延长，已有包括华润微、汇顶科技、意法半导体、Microchip、恩智浦等在内的多家半导体厂商发布涨价函，涨



幅平均在 10%-20%之间。

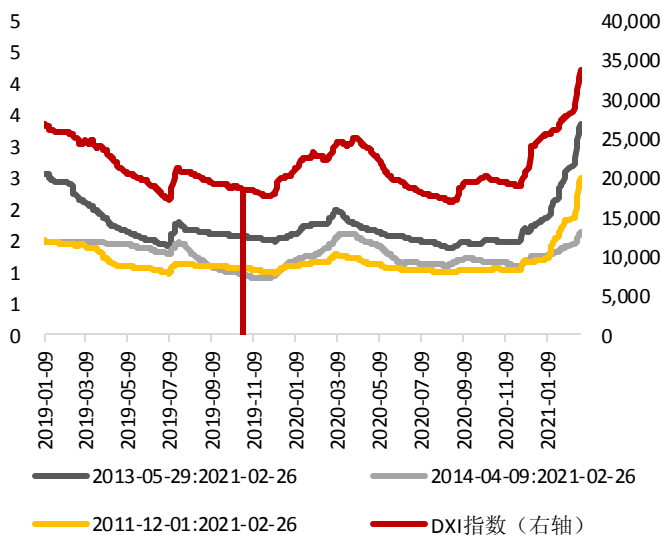
据 Digitimes ,MLCC 两大指标厂商韩国三星电机、日商 TDK 近期正式对一线组装厂客户发出通知,强调高容 MLCC 供应持续紧张,即将调涨 MLCC 报价。MLCC 涨价主要由于需求端,春节后 5G 手机需求爆发,叠加宅经济推升 PC 与笔记本电脑出货高景气、车用相关市场回升,带动被动元件领域需求,建议关注行业龙头标的:风华高科、顺络电子、三环集团等。

(2) DRAM、NAND 和 NOR Flash 全线涨价

NOR Flash 二季度预计涨价超 10%。需求端来自智能手机、PC、NB 以及 TWS 等市场的持续成长;供给端受美国暴风雪造成德州大停电的影响, IDM 大厂英飞凌当地工厂停工,英飞凌奥斯汀厂占全球 NOR 供应量的 5%、占车用 NOR 比重超过 30%,停工对供给量预期造成一定影响,使得报价提升,晶圆产能短缺加剧。根据供应链消息,华邦电和旺宏已经和客户在谈二季度报价,再度涨价 20%左右,远高于市场此前预测的 3%-7%。

Server DRAM 二季度预计涨价 10-15%。据 Trend Force,自 2020 年第三季至今,server DRAM 产能比重已降至三成左右,原因一方面为平衡产品线的供需失衡,另一方面为调整各产品线 DRAM 平均零售价(ASP)。此外,今年一季度消费性终端产品的需求动能未见趋缓,故原厂仍延续去年产能规划,二季度为传统 server 整机出货旺季,预期 server DRAM 需求将于第二季逐渐走强,进而使原厂在 server DRAM 的报价上更为积极,预估第二季合约价将从原先 8~13%的涨幅调升为 10~15%,不排除部分交易涨幅可达 20%。

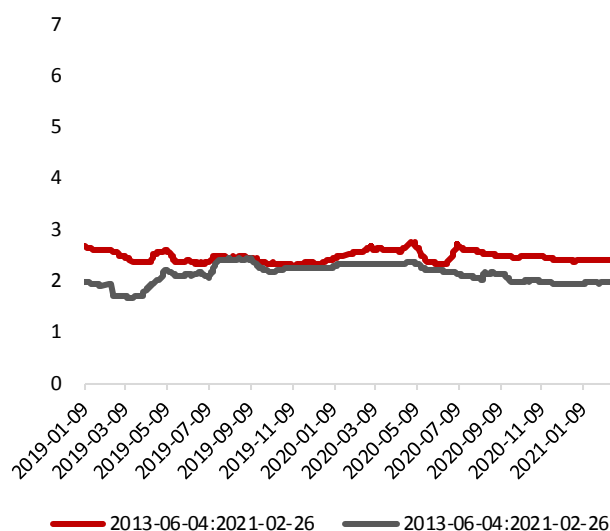
图表1: DRAM 现货平均价上涨(美元)



资料来源:wind、粤开证券研究院

注:数据更新至2021年2月26日

图表2: NANDFlash 现货平均价(美元)



资料来源:wind、粤开证券研究院

2021 年存储行业迎来高景气周期,关注国内龙头受益标的。根据 WSTS 数据,存储芯片在集成电路中市场规模占比 33.7%,是最主要的产品种类,而其中 DRAM 和 NAND 是两大最主要产品,IC Insight 预测 2021 年其销售额分别增长 18%和 17%。需求方面,电动车和智能网联汽车中车载娱乐、辅助驾驶等功能都需要存储芯片,叠加全球居家办公需求延续、车市复苏、手机市场实现两位数增长,以及 5G、云计算、



人工智能的快速发展带来的存储需求，存储行业进入需求高景气周期。近期 DRAM 现货价涨势加速，标准型 DRAM 价格创下近 2 年新高。国内存储龙头业务进展顺利，兆易创新公告拟在 2021 年向关联方长鑫存储购买 3 亿美元的 DRAM，同比增长 456%，DRAM 龙头长鑫存储 2020 年起量产 DDR4，最快 2021 年量产 DDR5。

图表3：WSTS 全球半导体市场规模预测

	百万美元			YoY (%)		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021
美洲	78,619	93,343	102,164	-23.7	18.7	9.5
欧洲	39,816	36,452	38,543	-7.3	-8.4	5.7
日本	35,993	35,759	37,841	-9.9	-0.6	5.8
亚太	257,879	267,590	290,854	-8.8	3.8	8.7
全球	412,307	433,145	469,403	-12	5.1	8.4
分立器件	23,881	23,593	25,292	-0.9	-1.2	7.2
光电子	41,561	40,481	44,628	9.3	-2.6	10.2
传感器	13,511	14,515	15,642	1.2	7.4	7.8
集成电路	333,354	354,556	383,840	-15.2	6.4	8.3
模拟IC	53,939	53,954	58,578	-8.2	0	8.6
微IC	66,440	67,744	68,444	-1.2	2	1
逻辑IC	106,535	113,419	121,507	-2.5	6.5	7.1
存储IC	106,440	119,440	135,311	-32.6	12.2	13.3
全部产品	412,307	433,145	469,403	-12	5.1	8.4

资料来源：WSTS、粤开证券研究院

3、预计一季度晶圆代工营收增长 20%

根据 Trend Force 集邦咨询，2021 年一季度全球晶圆代工市场供不应求持续，预估第一季全球前十大晶圆代工业者总营收年成长达 20%。

其中台积电 (TSMC)、三星 (Samsung)、联电 (UMC) 市占率排名前三。另外，增长率方面，华虹半导体的 8 英寸产能利用率持续满载、12 英寸添新动能，且去年同期也属低基期，可望推动第一季营收年成长至 42%；世界先进 (VIS) 各项制程产能皆已满载，第一季营收将持续受 PMIC 与小尺寸面板驱动 IC 产品规模提升带动，年增 26%；台积电预估第一季整体营收将再创新高，年增约 25%；力积电、中芯国际第一季营收预计分别年增 20%、17%。

图表4：2021 年一季度全球前十大晶圆代工业者营收排名预测 (百万美元)

Ranking	Company	1Q21E	1Q20	YoY	M/S
1	台积电(TSMC)	12,910	10,310	25%	56%
2	三星(Samsung)	4,052	3,660	11%	18%
3	联电(UMC)	1,603	1,402	14%	7%
4	格芯(GlobalFoundries)	1,469	1,355	8%	7%
5	中芯国际(SMIC)	1,059	905	17%	5%
6	高塔半导体(TowerJazz)	345	300	15%	2%
7	力积电(PSMC)	340	283	20%	2%
8	世界先进(VIS)	327	260	26%	1%
9	华虹半导体(Hua Hong)	288	203	42%	1%
10	东部高科(DB HiTek)	197	189	4%	1%
前十大合计		22,590	18,867	20%	100%

注：

(1)三星计入System LSI及晶圆代工事业部之营收

(2)格芯计入IBM业务收入

(3)力积电仅计入晶圆代工营收

(4)华虹半导体仅计算财报公开数字

Source: 各厂商；TrendForce整理, Feb., 2021

资料来源：TrendForce、粤开证券研究院



二、市场行情回顾

(一) 市场动态监测

上周(2021/2/22-2021/2/26)全球各大指数均有回落,其中创业板指表现回调幅度居前,回调11.30%,上证指数跌5.06%,申万电子指数下跌5.08%,半导体指数周下跌6.12%。

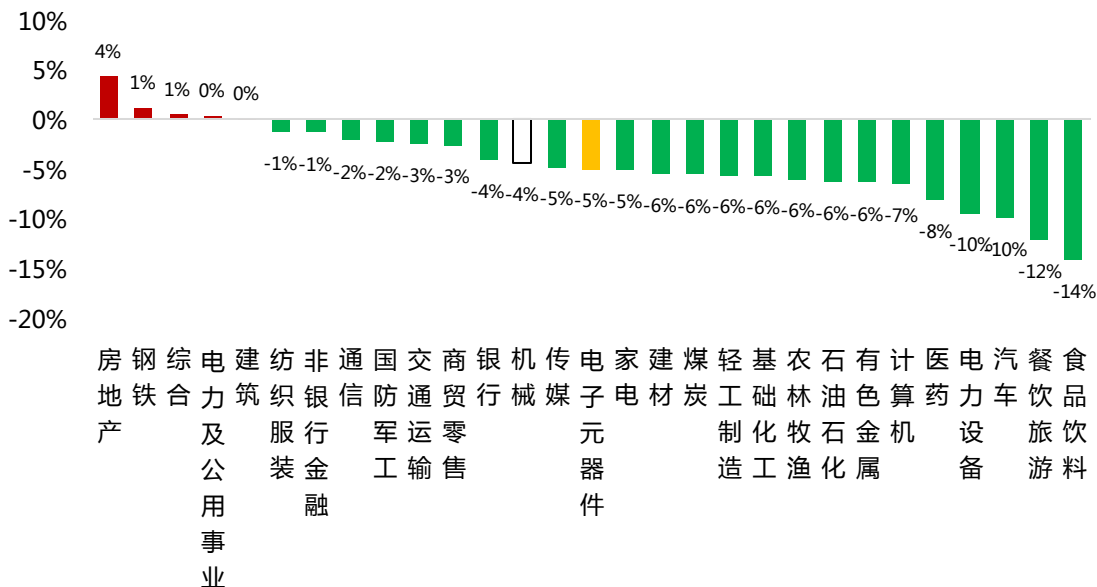
图表5: 上周主要指数情况

代码	名称	周报点	周涨跌幅	月涨跌幅	年涨跌幅
000001.SH	上证指数	3,509.08	-5.06%	0.75%	1.04%
399001.SZ	深证成指	14,507.45	-8.31%	-2.12%	0.25%
399006.SZ	创业板指	2,914.11	-11.30%	-6.86%	-1.76%
000300.SH	沪深300	5,336.76	-7.65%	-0.28%	2.41%
801080.SI	电子(申万)	4,636.48	-5.08%	-3.41%	-2.07%
SOX.GI	费城半导体指数	3,067.63	-4.83%	6.25%	9.73%
TWSE020	台湾电子指数	812.69	-4.35%	4.21%	12.82%
TWSE071	台湾半导体指数	408.46	-6.55%	3.84%	15.17%
886063.WI	半导体指数(申万)	5,420.16	-6.12%	-4.17%	-0.75%

资料来源: wind、粤开证券研究院

根据 Wind 数据,截止 2021 年 2 月 26 日,电子元器件(中信行业分类标准)周涨幅为-5.09%,在 29 个子行业中排名第 15 位,较上周提高 5 位。其中,房地产、钢铁、综合行业位列涨幅前三,周涨幅分别达 4.29%、1.16%和 0.53%。

图表6: 上周中信一级行业涨跌幅

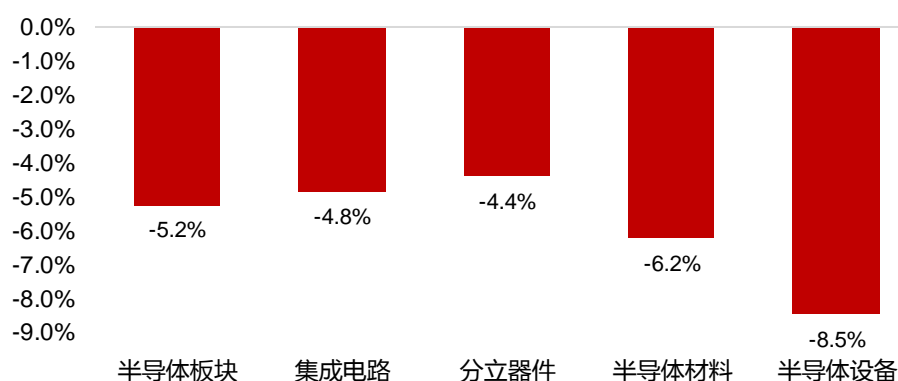


资料来源: wind、粤开证券研究院

根据 Wind 数据,截止 2021 年 2 月 26 日,半导体(中信行业二级分类标准)周涨幅为-5.2%,三级细分板块中,分立器件和集成电路分别下跌 4.4%和 4.8%,半导体材料和半导体设备板块回调较大。



图表7：上周半导体细分板块市场表现



资料来源：wind、粤开证券研究院

截止2021年2月26日,半导体指数的PE(TTM)为91.62倍,为近2年30.10%分位/近5年68.63%分位水平,较前一周有所回落(前一周为100.36倍)。

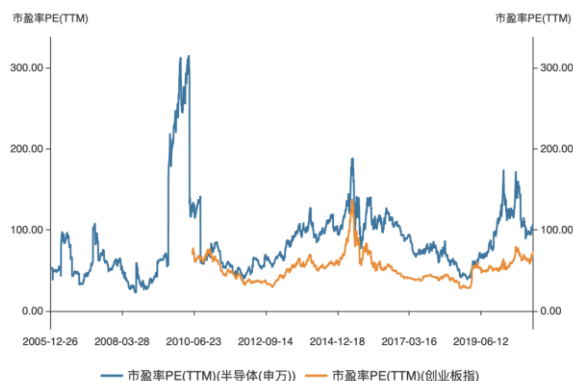
图表8：近五年申万半导体指数PE(TTM)



资料来源：wind、粤开证券研究院

注：数据更新至2021年2月26日

图表9：申万半导体指数与创业板指PE(TTM)对比



资料来源：wind、粤开证券研究院

图表10：上周半导体板块涨幅前十个股

代码	简称	净利润			PE			区间行情(%)	
		2020E	2021E	2022E	2020E	2021E	2022E	本周	本月
603931.SH	格林达	1.0	1.61	2.31	44.3	28.6	19.9	11.4	27.6
300390.SZ	天华超净	2.5	2.57	4.36	56.4	62.1	36.6	11.3	0.4
300139.SZ	晓程科技	-0.7	-	-	-54.6	-	-	9.9	7.0
688550.SH	瑞联新材	1.5	2.41	3.19	34.2	24.8	18.8	5.9	6.7
002180.SZ	纳思达	4.9	13.01	16.89	64.7	26.0	20.0	5.4	2.0
688233.SH	神工股份	0.6	1.19	1.55	59.9	50.3	38.6	5.1	-14.4
300077.SZ	国民技术	1.3	-	-	22.3	-	-	4.8	4.8
688368.SH	晶丰明源	0.5	1.47	2.34	158.4	73.6	46.2	4.4	-0.5
300046.SZ	台基股份	-2.6	-	-	-15.9	-	-	3.4	3.1
688200.SH	华峰测控	1.6	2.91	4.00	123.8	85.0	61.9	2.8	4.7
603893.SH	瑞芯微	2.7	4.25	5.61	99.9	62.6	47.5	2.8	4.7

资料来源：Wind、粤开证券研究院


图表11：上周半导体板块跌幅前十个股

代码	简称	净利润			PE			区间行情 (%)	
		2020E	2021E	2022E	2020E	2021E	2022E	本周	本月
688536.SH	思瑞浦	1.9	2.60	3.91	186.7	132.6	88.1	-23.8	-12.9
688008.SH	澜起科技	10.7	14.27	19.51	76.0	58.8	43.0	-18.1	-15.3
605358.SH	立昂微	1.7	3.01	3.96	230.9	114.5	87.2	-12.6	-5.4
003026.SZ	中晶科技	0.8	-	-	77.8	-	-	-12.2	-23.5
603005.SH	晶方科技	3.2	5.79	7.82	69.7	39.1	28.9	-11.3	-6.3
600745.SH	闻泰科技	31.6	41.59	54.38	42.1	30.2	23.1	-10.6	-4.3
688012.SH	中微公司	3.3	4.35	5.88	135.6	153.5	113.5	-10.6	-18.8
603290.SH	斯达半导	1.7	2.60	3.48	218.1	139.2	103.8	-10.6	1.1
002371.SZ	北方华创	4.9	7.45	10.39	214.0	119.6	85.8	-9.5	-10.5
688608.SH	恒玄科技	1.4	4.07	6.01	174.7	85.2	57.7	-9.4	-13.2
002156.SZ	通富微电	3.5	7.07	9.54	104.3	45.5	33.7	-8.7	-11.8

资料来源：Wind、粤开证券研究院

(二) 高频数据跟踪

图表12：台股半导体企业月度营收数据（更新至21年1月）

接行业加总	月度营收 (亿新台币)	台股半导体企业月度营收										月度同比 (%)
		Jan-21	Dec-20	Nov-20	Oct-20	Sep-20	Aug-20	Jul-20	Jun-20	May-20	Apr-20	
IC设计	785.4	735.5	750.9	717.9	815.3	703.1	627.7	573.0	533.3	530.2		
IC制造	1628.3	1533.9	1595.9	1554.5	1651.4	1554.3	1387.0	1530.8	1262.5	1293.2		
IC封装测试	450.7	455.1	438.8	427.4	421.9	440.0	430.9	419.9	419.4	420.1		
被动元件	238.3	209.4	217.4	204.3	222.7	208.8	203.9	168.3	168.1	169.7		
DRAM	204.5	195.7	193.4	190.4	211.0	159.7	159.8	164.1	159.7	158.0		
半导体材料	70.4	74.6	71.3	70.3	74.0	68.2	68.5	74.4	66.3	67.5		
公司												
联发科 (IC设计)	353.3	324.3	335.4	304.4	378.7	327.2	266.9	252.8	217.8	205.5		
台积电 (IC制造)	1267.5	1173.6	1248.7	1193.0	1275.8	1228.8	1059.6	1208.8	938.2	960.0		
日月光 (封测)	408.5	503.0	506.6	479.1	439.3	419.4	373.3	364.6	357.9	353.0		
晶技 (被动元件)	12.0	10.7	10.7	10.9	11.8	10.1	9.6	8.2	8.4	8.7		
中美晶 (材料)	49.1	54.9	51.4	50.8	55.2	49.7	48.9	55.1	46.8	48.4		

资料来源：wind、粤开证券研究院

(三) 公司公告

图表13：近期重要公司公告一览

日期	公告名称	公告内容
2021-02-26	中颖电子:2020年度业绩快报	公司实现营业收入101,225万元,较上年同期增长21.35%;归属于上市公司股东的净利润为20,960万元,较上年同期增长10.71%;基本每股收益为0.7509元。公司销售增长主要受各领域客户需求强劲增长所致,但仍受限于上游晶圆厂的产能供应不足。销售增量由大到小依序是锂电池管理、家电主控、电机控制、AMOLED显示驱动、电脑周边及IOT和智能电表芯片,PMOLED显示驱动芯片销售则同比下滑。



2021-02-27	沪硅产业:2020年度业绩快报公告	报告期内,公司营业收入在300mm半导体硅片销量增加的带动下,以及公司2019年3月并购新傲科技的综合影响下,较上年同期增加了约21.36%。 公司报告期的归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润从上年同期的-23,737.45万元下降到-28,064.76万元,主要是由于公司300mm半导体硅片业务仍处于产能爬坡阶段,固定成本持续增加,同时公司始终保持对于300mm半导体硅片研发的高投入导致研发费用较上年同期增幅较大所致。
2021-02-25	卓胜微:2020年度业绩快报	2020年度,公司实现营业总收入279,215.43万元,较上年同期增长84.62%;利润总额122,416.82万元,较上年同期增长117.57%;营业利润122,530.94万元,较上年同期增长117.78%;归属于上市公司股东的净利润105,740.77万元,较上年同期增长112.69%。 公司营业总收入、利润总额、营业利润、归属于上市公司股东的净利润以及基本每股收益同比增长,以上增长主要系公司主营业务增长所致。
2021-02-26	华润微:2020年度业绩快报公告	2020年度,公司实现营业收入697,701.03万元,较上年同期增长21.49%;营业利润106,845.59万元,较上年同期增长123.64%;利润总额108,242.03万元,较上年同期增长113.94%;归属于母公司所有者的净利润96,046.84万元,较上年同期增长139.66%;归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润84,995.45万元,较上年同期增长311.98%;基本每股收益0.8334元,较去年同期增长82.80%。
2021-02-26	芯海科技:2020年年度业绩快报公告	2020年内,公司实现营业收入36,279.6万元,较上年同期增长40.4%;实现归属于母公司所有者的净利润8,911.34万元,较上年同期增长108.20%;实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润5,931.19万元,较上年同期增长58.91%。 2020年度,半导体行业景气度持续向好,公司通过高精度ADC、高性能MCU等核心技术打造全信号链产品竞争优势,在健康测量应用领域保持持续增长,在模拟信号链领域,突破工业测量、汽车电子、消费电子等行业标杆客户,形成营收新的增长点。
2021-02-26	晶晨股份:2020年度业绩快报公告	2020年上半年受疫情影响,公司下游终端客户订单需求量减少,公司营业收入同比出现一定程度下降,第一季度、第二季度收入同比分别下降28.23%、下降4.45%,同时因持续的运营投入,相关费用同比上升,造成亏损。 2020年下半年受益于疫情防控形势的好转,国内市场需求回暖以及海外市场需求进一步提升,公司经营业绩持续向好,连续两个季度营业收入创历史新高,第三季度、第四季度收入同比分别增长41.95%、增长49.44%,其中,第四季度实现营业收入97,348.59万元,单季度净利润突破亿元。
2021-02-26	澜起科技:2020年度业绩快报公告	报告期内,公司主要经营业务稳定发展。公司实现营业收入182,366.56万元,较上年度增长4.94%;实现归属于母公司所有者的净利润110,368.35万元,较上年度增长18.31%;实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润75,968.96万元,较上年度下降9.01%。受行业去库存影响,公司2020年下半年营业收入较上年同期有所下降。 报告期内,公司销售收入主要来自于互连类芯片产品线(目前包括内存接口芯片及其配套芯片、PCIeRetimer芯片等)及津逮®服务器平台产品线(包括津逮®CPU及混合安全内存模组)。其中,互连类芯片产品线(报告期内主要为内存接口芯片)实现销售收入179,401.55万元,同比增长4.21%;津逮®服务器平台产品线实现销售收入2,965.01万元,同比增长82.17%。
2021-02-26	敏芯股份:2020年度业绩快报公告	公司实现营业总收入33,007.47万元,同比增长16.21%;实现归属于母公司所有者的净利润4,275.27万元,同比减少28.13%;实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润3,549.53万元,同比减少30.31%。



2021-02-26	睿创微纳:2020 年度业绩快报公告	公司实现营业收入 156,144.25 万元,同比增长 128.06%;实现利润总额 66,690.25 万元,同比增长 199.45%;实现归属于母公司所有者的净利润 58,656.50 万元,同比增长 190.28%;报告期末总资产 354,675.67 万元,较期初增长 39.40%;归属于母公司的所有者权益 293,396.57 万元,较期初增长 25.28%。
2021-02-25	中微公司:2020 年度业绩快报公告	报告期内,公司实现营业收入 227,329.19 万元,较上年同期增长 16.76%;归属于母公司所有者的净利润 49,219.92 万元,较上年同期增长 161.02%;归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为 2,331.94 万元,较上年同期减少 84.19%。于报告期末,公司总资产为 580,087.69 万元,较报告期初增加 21.51%;归属于母公司的所有者权益 436,893.42 万元,较报告期初增加 16.47%。
2021-02-25	寒武纪:2020 年度业绩快报公告	报告期内,公司实现营业收入 45,892.73 万元,较上年同期增长 3.38%。研发费用较上年同期有较大幅度的增加。人员规模的增长导致公司本报告期内整体人员成本和办公场地等投入有较大幅度的增加,公司报告期内闲置资金管理收益及收到的政府补助较上年同期增加,股份支付金额较上年同期减少。综合以上因素,公司实现归属于母公司所有者的净利润为-43,573.95 万元,亏损金额较上年同期减少 63.04%;归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-65,984.80 万元,亏损金额较上年同期扩大 75.15%。
2021-02-25	芯原股份:2020 年年度业绩快报公告	2020 年度公司实现营业收入 15.06 亿元,同比增长 12.40%;本年度归属于母公司所有者的净利润为-2,556.64 万元,亏损进一步收窄,收窄幅度为 37.90%;归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-10,658.51 万元,扣非后亏损增加 596.01 万元。
2021-02-25	思瑞浦:2020 年度业绩快报公告	经营情况: 公司 2020 年度实现营业收入 56,648.85 万元,同比增长 86.61%;实现归属于母公司所有者的净利润 18,462.89 万元,同比增长 160.11%;实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 16,810.97 万元,同比增长 156.94%。 影响经营业绩的主要因素: 2020 年度,在半导体行业景气度持续向好的背景下,公司线性和转换器等信号链产品收入大幅增长,并且随着电源类新产品不断投放市场,电源类芯片产品的收入稳步提升。同时,期间费用增长幅度也低于收入增长幅度;另外,因确认上市前相关股权激励费用及实施 2020 年限制性股票激励计划,公司 2020 年度发生股份支付费用 2,544.07 万元,同比增长 103.44% (该股份支付费用在经常性损益项目下列支);公司 2020 年度非经常性损益同比大幅增长,主要系公司利用暂时闲置募集资金购买理财产品产生的收益。
2021-02-25	芯源微:2020 年度业绩快报公告	报告期内,实现营业总收入 32,890.02 万元,同比增长 54.30%;实现利润总额 5,282.31 万元,同比增长 68.82%;实现归属于母公司所有者的净利润 4,882.86 万元,同比增长 66.79%;实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 1,287.51 万元,同比下降 13.78%。 影响经营业绩的主要因素:报告期内半导体行业景气度持续向好,业务规模持续增长,2020 年公司实现营业收入及归属于母公司所有者的净利润较上年同期有较大增长。同时,公司持续加大研发投入和技术人员储备等导致期间费用较上年同期增长,从而归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润较上年同期有所下降。

资料来源:Wind、粤开证券研究院



(三) 行业动态

图表14：近期行业新闻梳理

新闻	来源
<p>闻泰科技在公司官方网站上披露，闻泰科技安世半导体位于上海临港的12寸晶圆厂已于今年一月破土动工，将于2022年7月投产，产能预计将达到每年40万片。</p> <p>2020年8月19日，中国第一座12英寸车规级功率半导体自动化晶圆制造中心项目正式签约落户上海临港。该项目由闻泰科技投资建设，是其半导体业务实现100亿美元战略目标的第一步。</p>	集微网
<p>SK海力士将购入价值4.8万亿韩元的EUV光刻机设备。SK海力士于2月24日宣布，已与ASML签订了一项为期5年、价值4.8万亿韩元(约43.4亿美元)的采购合同。</p> <p>报道指出，SK海力士在一份监管文件中称，这笔交易是为了实现下一代工艺芯片量产的目标。SK海力士计划运用EUV光刻机，从今年下半年起生产第四代1a纳米级DRAM产品。SK海力士今后将提高EUV设备利用率，进一步增强存储器半导体相关的先进工程技术领导力。</p>	路透社
<p>北京时间2月25日，英伟达公布了2021财年第四季度及全年财报。报告显示，英伟达第四季度营收为50.03亿美元，与上年同期的31.05亿美元相比增长61%，与上一季度的47.26亿美元相比增长6%；净利润为14.57亿美元，与上年同期的9.50亿美元相比增长53%，与上一季度的13.36亿美元相比增长9%；不计入某些一次性项目（不按照美国通用会计准则），英伟达第四季度调整后净利润为19.57亿美元，与上年同期的11.72亿美元相比增长67%，与上一季度的18.34亿美元相比增长7%。</p>	英伟达
<p>多家半导体企业准备上市：</p> <p>近日，上海监管局披露了泰凌微电子（上海）股份有限公司（以下简称“泰凌微”）、上海伟测半导体科技股份有限公司（以下简称“伟测半导体”）、以及上海兰宝传感科技股份有限公司（以下简称“兰宝传感”）的上市辅导备案情况报告公示。</p> <p>泰凌微：成立于2010年，主要致力于提供具有成本效益的低功耗物联网无线通信芯片及配套解决方案。天眼查信息显示，目前，国家大基金是泰凌微的第一大股东，持股比例为11.94%，华胜天成持股9.92%，为第二大股东，而小米长江产业基金则持股较少，为1.58%。</p> <p>伟测半导体：成立于2016年，是一家专注于集成电路产业的测试服务提供商，主要从事晶圆及芯片成品的产业化测试服务、晶圆测试程序开发和数据支持服务、晶圆仓储与物流服务。其主要客户包括长电科技、晶丰明源、复旦微电子等国内国际知名芯片企业。</p> <p>兰宝传感：成立于1998年，全国先进的工业离散传感器核心供应商之一，专业从事传感技术、传感测控系统及解决方案及服务。目前，该公司工业测控传感器的产品主要包括测量传感器、光电传感器、接近传感器和自动化光幕传感器、编码器等系列产品。</p> <p>芯导科技：上海芯导电子科技股份有限公司近日完成了上市辅导。芯导科技成立于2009年11月，是一家专注于高品质、高性能的模拟集成电路和功率器件研发及销售的芯片企业，产品主要包括功率器件和功率IC。</p>	各公司公告

资料来源：公开信息整理、粤开证券研究院整理



分析师简介

陈梦洁，硕士研究生，2016 年加入粤开证券，现任策略组负责人，证书编号：S0300520100001。

分析师声明

作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力，保证报告所采用的数据均来自合规渠道，分析逻辑基于作者的职业理解，本报告清晰准确地反映了作者的研究观点，力求独立、客观和公正，结论不受任何第三方的授意或影响，特此声明。

与公司有关的信息披露

粤开证券具备证券投资咨询业务资格，经营证券业务许可证编号：10485001。
本公司在知晓范围内履行披露义务。

股票投资评级说明

投资评级分为股票投资评级和行业投资评级。

股票投资评级标准

报告发布日后的 12 个月内公司股价的涨跌幅度相对同期沪深 300 指数的涨跌幅为基准，投资建议的评级标准为：

- 买入：相对大盘涨幅大于 10%；
- 增持：相对大盘涨幅在 5%~10%之间；
- 持有：相对大盘涨幅在-5%~5%之间；
- 减持：相对大盘涨幅小于-5%。

行业投资评级标准

报告发布日后的 12 个月内行业股票指数的涨跌幅度相对同期沪深 300 指数的涨跌幅为基准，投资建议的评级标准为：

- 增持：我们预计未来报告期内，行业整体回报高于基准指数 5%以上；
- 中性：我们预计未来报告期内，行业整体回报介于基准指数-5%与 5%之间；
- 减持：我们预计未来报告期内，行业整体回报低于基准指数 5%以下。



免责声明

本报告由粤开证券股份有限公司（以下简称“粤开证券”）提供，旨在派发给本公司客户使用。未经粤开证券事先书面同意，不得以任何方式复印、传送或出版作任何用途。合法取得本报告的途径为本公司网站及本公司授权的渠道，非通过以上渠道获得的报告均为非法，我公司不承担任何法律责任。

本报告基于粤开证券认为可靠的公开信息和资料，但我们对这些信息的准确性和完整性均不作任何保证，也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。粤开证券可随时更改报告中的内容、意见和预测，且并不承诺提供任何有关变更的通知。本公司力求报告内容的客观、公正，但文中的观点、结论和建议仅供参考，不构成所述证券的买卖出价或询价，投资者据此做出的任何投资决策与本公司和作者无关。在本公司及作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐的证券没有利害关系。

本公司利用信息隔离墙控制内部一个或多个领域、部门或关联机构之间的信息流动。因此，投资者应注意，在法律许可的情况下，本公司及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券或期权交易，也可能为这些公司提供或者争取提供投资银行、财务顾问或者金融产品等相关服务。在法律许可的情况下，本公司的员工可能担任本报告所提到的公司的董事。

市场有风险，投资需谨慎。投资者不应将本报告作为作出投资决策的唯一参考因素，亦不应认为本报告可以取代自己的判断。在决定投资前，如有需要，投资者务必向专业人士咨询并谨慎决策。

本报告版权仅为本公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用。如征得本公司同意进行引用、刊发的，须在允许的范围内使用，并注明出处为“粤开证券研究”，且不得对本报告进行任何有悖意愿的引用、删节和修改。

投资者应根据个人投资目标、财务状况和需求来判断是否使用资料所载之内容和信息，独立做出投资决策并自行承担相应风险。我公司及其雇员做出的任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。

联系我们

广州市黄埔区科学大道 60 号开发区金控中心 21-23 层

北京市朝阳区红军营南路绿色家园媒体村天畅园 6 号楼 2 层

上海市浦东新区源深路 1088 号平安财富大厦 20 层

网址：www.ykzq.com